

Buchsenleiste - gerade/gewinkelt - 1-/2-reihig - RM 2,00mm Female Header - Straight/Right Angled - Single and Double Row - Pitch 2,00mm

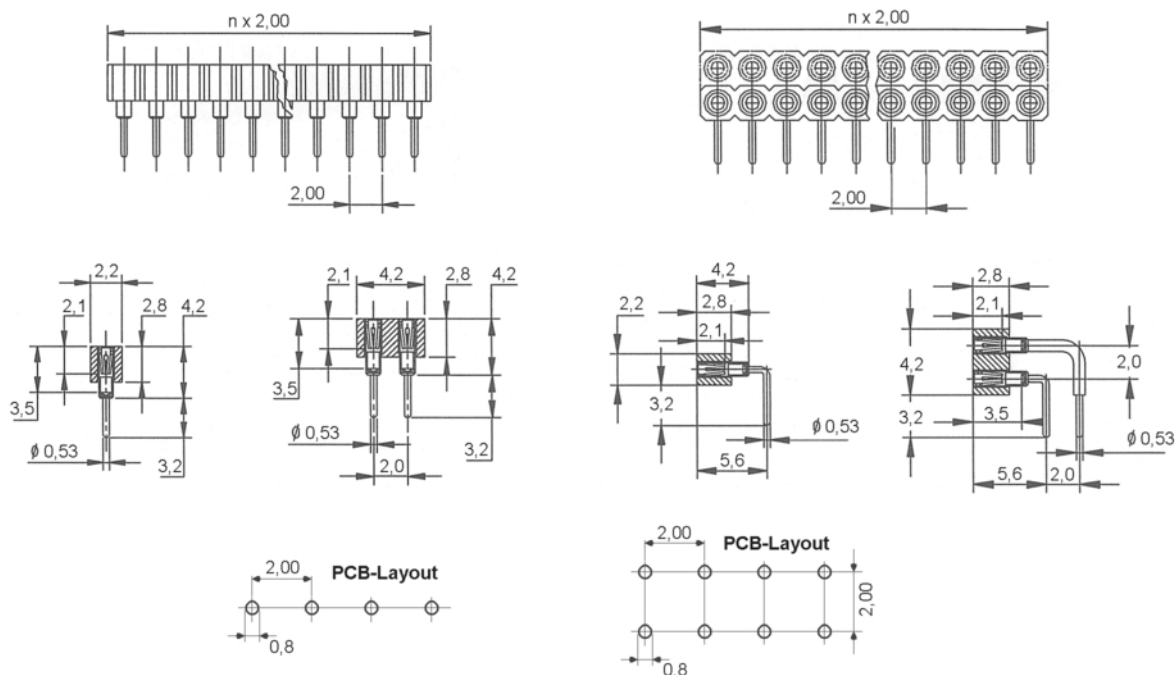
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ¹⁰ Ω
Insulation Resistance	> 10 ¹⁰ Ω
Spannungsfestigkeit	1000V _{RMS}
Test Voltage	1000V _{RMS}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm
oder Vierkantstift 0,25 x 0,45mm.
For round pins Ø 0,4 ... 0,56mm
or rectangular pin 0,25 x 0,45mm.



Series	Contacts*	Type*	Sleeve Plating	Plating*	Clip (Optional)*
257	72	4	50	30	6
	01-64 Einreihig Single row 02-72 Zweireihig Double row	1 Einreihig, gerade Single row, straight 2 Zweireihig, gerade Double row, straight 3 Einreihig, gewinkelt Single row, right angled 4 Zweireihig, gewinkelt Double row, right angled	50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	10 Feder 0,25µm Gold 0,25µm gold plated clip 30 Feder 0,75µm Gold 0,75µm gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated	6 6-Lamellen-Clip für Vierkantstift 0,5mm 6 Finger Clip for square pin 0,5mm

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

(* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

